TM ライニング工法

2002 年（平成 14 年）

下水道管路の補修再生に用いられている市中技術を応用したもので、ケーブルが収容されていない管路（空管）の内部に、樹脂系のライニング材を挿入し、新たに３mm 程度の厚みを持った樹脂膜を形成することにより管路を再生します。強度不足等で使用出来なかった管路に対し使用する事で低コストで光ケーブル等の布設空間を確保できます（図）。

対象は、強度不足が懸念される内径φ75mm の金属管です。

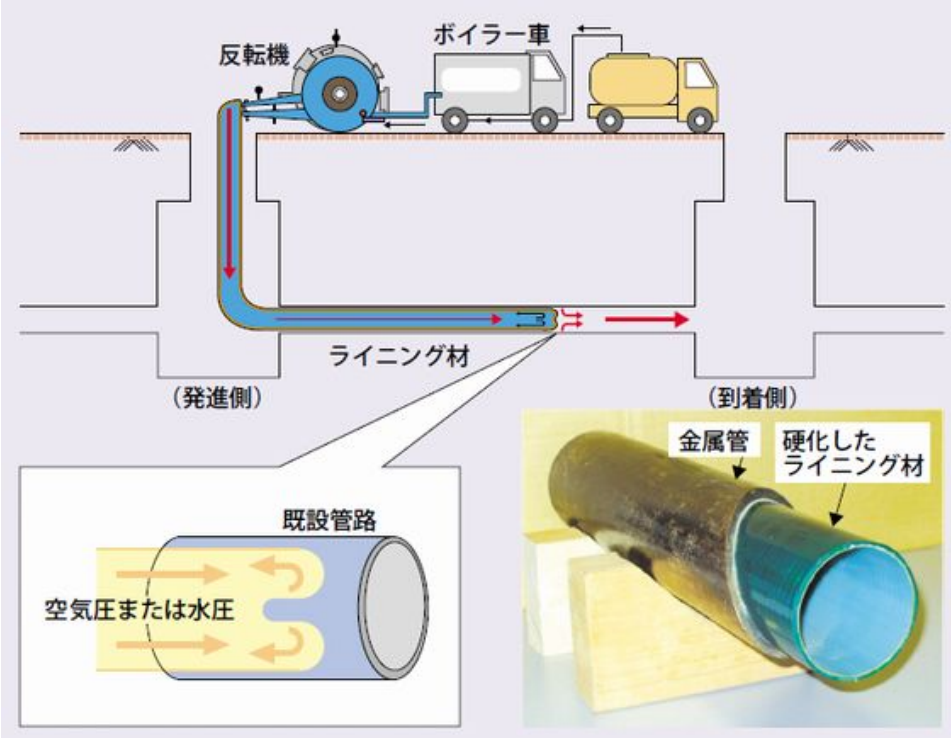

図　TM ライニング技術の概要

このサイトから発信される記事・写真・プログラム等情報の無断転載を禁じます。著作権はＮＴＴアクセスサ-ビスシステム研究所に帰属します。
Copyright©NTT Access Network service systems Laboratories. No reproduction or republication without written permission.